

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
26. Februar 2004 (26.02.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/017074 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G01N 35/00, B01J 19/00**

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): STANZEL, Manfred [DE/DE]; Taunusstrasse 100, 91056 Erlangen (DE). GUM-BRECHT, Walter [DE/DE]; In der Röte 1, 91074 Herzogenaurach (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002444

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
21. Juli 2003 (21.07.2003)

(81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, JP, US.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

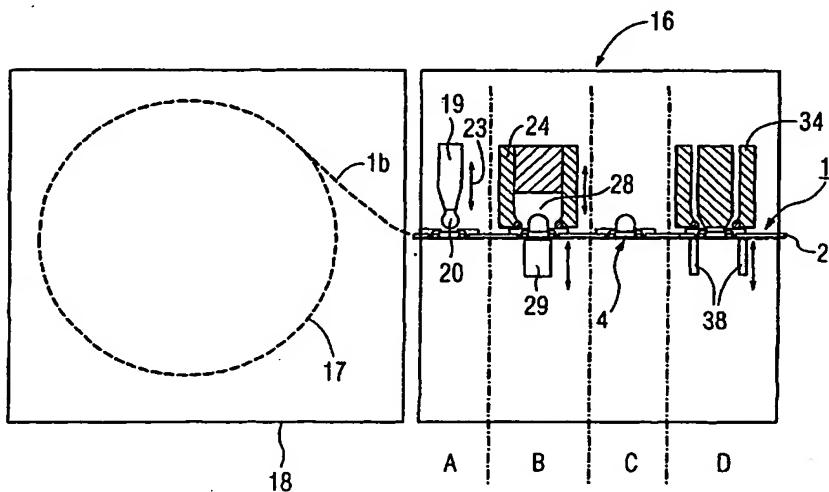
Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PERFORMING HIGH-THROUGHPUT ANALYSES AND DEVICE FOR CARRYING OUT THIS METHOD

(54) Bezeichnung: VERFAHREN FÜR HOCHDURCHSATZANALYSEN UND VORRICHTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS



(57) Abstract: The invention relates to a method for performing a high-throughput analysis, according to which processing simultaneously ensues in a continuous manner at a number of work stations (A, B, C, D). In order to improve the sample throughput, the invention provides that a support (2; 2a), which comprises a multitude of spots (11), particularly a number of spot arrays (11, 11a), is used that is moved in a timed manner through the work stations (A; B; C, D). The corresponding device comprises a bio-chip arrangement (1) having a multitude of spots (11), particularly a number of spot arrays (11; 11a) that are arranged in an interspaced manner on a common support (2; 2a) made of a flat material.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/017074 A1